

手握中国芯，改写半导体格局

计算机行业周报

本周观点：

► 一、中国筑牢稀土安全护城河

中国再次加码对稀土的出口管制，明确向境外军事用户出口、向被列入管控名单的实体出口、出口可能被用于大规模杀伤性武器、恐怖主义或军事用途这三种情况“原则上不予许可”。稀土是支撑设备精密化、材料高性能化与工艺先进化的关键基础材料，其应用贯穿半导体制造全链条。中国作为占全球稀土产量近70%的“稀土大户”，此次加码稀土出口管制，无疑是卡住了美国半导体行业的“命门”。

► 二、全球首颗“二维-硅基”混合闪存芯片问世

当前大数据与人工智能时代对数据存取性能提出了极致要求，而传统存储器技术正面临严峻挑战。多国芯片巨头上调产品价格，为中国企业带来了直接成本压力，同时涨价也伴随着供应的不稳定与交付周期延长，面对潜在的供应链安全风险，中国拥有自己的先进芯片技术“迫在眉睫”。复旦大学周鹏-刘春森团队研发的“长缨（CY-01）”架构，将二维超快闪存器件“破晓（PoX）”与成熟硅基 CMOS 工艺深度融合，率先研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片，性能“碾压”目前的 Flash 闪存技术，首次实现了混合架构的工程化。本次技术突破使我国在下一代存储核心技术领域率先掌握了主动权，为人工智能、大数据等前沿领域提供更高速度、更低能耗的数据支撑。

► 三、半导体行业会议前瞻：透视中国半导体发展新路径

2025 年湾区半导体产业生态博览会，汇集半导体行业顶尖决策者，共同探讨行业未来发展方向。第三届第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大赛聚焦第三代半导体产业前沿技术与发展趋势，探讨半导体产业最新技术突破，推动长三角区域半导体产业协同发展。2025 中国半导体先进封装大会暨中国半导体晶圆制造大会围绕“晶圆制造是根

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：刘泽晶

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520020002

联系电话：

分析师：李静远

邮箱：lijy5@hx168.com.cn

SAC NO: S1120525090002

联系电话：

基，先进封装是突破方向”核心议题展开深度研讨，凝聚产学研用多方智慧。2025 半导体显示产业年会将发布《2025 MLED 显示产业白皮书》，为从业者提供从技术攻坚到商业落地、从产业现状到市场趋势的全景导航。行业盛会的召开有助于中国半导体产业在全球新格局中找准定位、发挥优势、补齐短板，提升中国半导体产业的全球竞争力与创新力，为我国半导体产业注入新动能。

► 四、投资建议

受益标的：

半导体：北方华创、中微公司、中芯国际、晶合集成、燕东微、华虹半导体等。

芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

存储：德明利、开普云、深科技、香农芯创、江波龙等。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、市场竞争加剧。

盈利预测与估值

重点公司											
股票代码	股票名称	收盘价(元)	投资评级	EPS(元)				P/E			
				2021A	2022A	2023A	2024A	2021A	2022A	2023A	2024A
600570.SH	恒生电子	34.02	买入	1.01	0.57	0.75	0.55	33.68	59.68	38.37	50.82
300496.SZ	中科创达	73.99	买入	1.53	1.68	1.01	0.89	48.36	44.04	78.98	67.24
002230.SZ	科大讯飞	55.97	买入	0.70	0.17	0.28	0.24	79.96	329.24	163.40	199.41
300454.SZ	深信服	114.04	买入	0.67	0.47	0.47	0.47	170.21	242.64	153.40	123.00
300682.SZ	朗新集团	19.05	买入	0.83	0.48	0.55	(0.23)	22.95	39.69	29.76	(52.92)
600588.SH	用友网络	15.30	买入	0.22	0.06	(0.28)	(0.60)	69.55	255.00	(62.88)	(17.79)
300674.SZ	宇信科技	24.82	买入	0.61	0.36	0.46	0.54	40.69	68.94	35.52	36.18
688111.SH	金山办公	297.00	买入	2.26	2.42	2.86	3.56	131.42	122.73	110.79	80.52
300803.SZ	指南针	154.30	买入	0.44	0.83	0.18	0.25	350.68	185.90	339.33	379.91

注：朗新集团（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。

正文目录

1. 手握中国芯，改写半导体格局.....	4
2. 手握中国芯，改写半导体格局.....	5
2.1. 中国筑牢稀土安全护城河.....	5
2.2. 全球首颗“二维-硅基”混合闪存芯片问世.....	5
2.3. 半导体行业会议前瞻：透视中国半导体发展新路径.....	9
3. 本周行情回顾.....	14
3.1. 行业周涨跌及成交情况.....	14
3.2. 个股周涨跌、成交及换手情况.....	16
3.3. 核心推荐标的行情跟踪.....	17
3.4. 整体估值情况.....	17
4. 本周重要公告汇总.....	18
5. 本周重要新闻汇总.....	19
6. 历史报告回顾.....	24
7. 风险提示.....	26

图表目录

图 1 多国芯片巨头上调产品报价.....	6
图 2 “破晓 (PoX)” 皮秒闪存器件.....	6
图 3 封装后的二维-硅基混合架构闪存芯片.....	6
图 4 二维-硅基混合架构闪存芯片结构示意图.....	7
图 5 团队 2024 年发表于 Nature Electronics 的文章.....	8
图 6 二维-硅基混合架构闪存芯片光学显微镜照片.....	8
图 7 二维-硅基混合架构闪存芯片透射电子显微镜图.....	8
图 8 TOP20 高层战略研讨闭门会.....	10
图 9 第九届国际先进光刻技术研讨会.....	10
图 10 “湾芯展” 部分技术论坛日程表.....	10
图 11 第三代半导体产业技术创新战略联盟简介.....	11
图 12 第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大赛日程安排.....	12
图 13 2025 中国半导体先进封装大会暨中国半导体晶圆制造大会演讲企业及议题.....	13
图 14 2025 半导体显示产业年会亮点内容.....	14
图 15 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (本周).....	15
图 16 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (2025 年初至今).....	15
图 17 计算机行业周平均日成交额 (亿元).....	16
图 18 申万计算机行业周涨幅前五 (%) (本周).....	16
图 19 申万计算机行业周跌幅前五 (%) (本周).....	16
图 20 申万计算机行业日均成交额前五 (亿元).....	17
图 21 申万计算机行业日均换手率前五 (%).....	17
图 22 本周核心推荐标的行情.....	17
图 23 申万计算机行业估值情况 (2010 年至今).....	18

1. 手握中国芯，改写半导体格局

一、中国筑牢稀土安全护城河

中国再次加码对稀土的出口管制，明确向境外军事用户出口、向被列入管控名单的实体出口、出口可能被用于大规模杀伤性武器、恐怖主义或军事用途这三种情况“原则上不予许可”。稀土是支撑设备精密化、材料高性能化与工艺先进化的关键基础材料，其应用贯穿半导体制造全链条。中国作为占全球稀土产量近 70% 的“稀土大户”，此次加码稀土出口管制，无疑是卡住了美国半导体行业的“命门”。

二、全球首颗“二维-硅基”混合闪存芯片问世

当前大数据与人工智能时代对数据存取性能提出了极致要求，而传统存储器技术正面临严峻挑战。多国芯片巨头上调产品价格，为中国企业带来了直接成本压力，同时涨价也伴随着供应的不稳定与交付周期延长，面对潜在的供应链安全风险，中国拥有自己的先进芯片技术“迫在眉睫”。复旦大学周鹏-刘春森团队研发的“长缨（CY-01）”架构，将二维超快闪存器件“破晓（PoX）”与成熟硅基 CMOS 工艺深度融合，率先研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片，性能“碾压”目前的 Flash 闪存技术，首次实现了混合架构的工程化。本次技术突破使我国在下一代存储核心技术领域率先掌握了主动权，为人工智能、大数据等前沿领域提供更高速度、更低能耗的数据支撑。

三、半导体行业会议前瞻：透视中国半导体发展新路径

2025 年湾区半导体产业生态博览会，汇集半导体行业顶尖决策者，共同探讨行业未来发展方向。第三届第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大赛聚焦第三代半导体产业前沿技术与发展趋势，探讨半导体产业最新技术突破，推动长三角区域半导体产业协同发展。2025 中国半导体先进封装大会暨中国半导体晶圆制造大会围绕“晶圆制造是根基，先进封装是突破方向”核心议题展开深度研讨，凝聚产学研用多方智慧。2025 半导体显示产业年会将发布《2025 MLED 显示产业白皮书》，为从业者提供从技术攻坚到商业落地、从产业现状到市场趋势的全景导航。行业盛会的召开有助于中国半导体产业在全球新格局中找准定位、发挥优势、补齐短板，提升中国半导体产业的全球竞争力与创新力，为我国半导体产业注入新动能。

四、投资建议：

受益标的：

半导体：北方华创、中微公司、中芯国际、晶合集成、燕东微、华虹半导体等。

芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

存储：德明利、开普云、深科技、香农芯创、江波龙等。

2. 手握中国芯，改写半导体格局

2.1. 中国筑牢稀土安全护城河

中国再度加码对稀土的出口管制。10月9日，商务部连发两则公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项及相关技术实施出口管制。管制条例中明确列出了三种“原则上不予许可”的情形：一是向境外军事用户出口；二是向被列入管控名单的实体出口；三是出口可能被用于大规模杀伤性武器、恐怖主义或军事用途。特别是针对那些可能“提升军事潜力”的用途，审批门槛被大幅提高。例如，用于研发14纳米以下芯片或256层以上存储芯片的稀土材料，将实行逐案审批；而用于军事人工智能技术的申请，则可能直接被拒绝。

在技术密集型的半导体产业中，稀土是支撑设备精密化、材料高性能化与工艺先进化的关键基础材料，其应用贯穿半导体制造全链条。包括光刻机的晶圆台等半导体设备，半导体材料、耗材和试剂，稀土掺杂半导体材料，稀磁半导体等方面，稀土均为重要的战略材料。据美国地质调查局（USGS）数据，2024年，中国稀土产量为27万吨，占全球总产量的69.2%。对美国而言，中国此次加码稀土出口管制，无疑是卡住了美国半导体行业的“命门”。美国总统特朗普不满中国加强稀土相关物项出口管制，宣布从11月1日起对中国输美商品征收额外100%的关税，并会对所有关键软件实施出口管制。

2.2. 全球首颗“二维-硅基”混合闪存芯片问世

当前大数据与人工智能时代对数据存取性能提出了极致要求，当下的AI系统瓶颈正在从前端的算力转向后端的存储和数据，未来的模型会越来越庞大，而传统存储器技术正面临严峻挑战。目前最常见的存储器为易失性存储器，这是一种断电后数据丢失的存储装置，主要用于计算机系统临时存储操作系统及运行中的程序和数据。这种存储器具备相当的灵活性，在任何时候都可以读写，但具有数据临时性，分为静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）两大类，其中DRAM因成本低、集成度高而被广泛用作计算机主存，SRAM因无需刷新、速度快而多用于CPU高速缓存。易失性存储器的速度为1—30纳秒，但断电后数据会丢失，传统闪存不会轻易丢失数据，但工作效率远远落后于芯片算力。

近半年来，全球存储芯片迎来显著变化，多国芯片巨头纷纷上调产品报价。三星电子在9月下旬发出第四季度提价通知，计划将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%；美光科技在暂停部分报价后，恢复时新价格普遍上涨约20%；闪迪也将NAND闪存报价上调约10%。这一轮涨价主要受生成式AI快速发展对高带宽内存HBM的需求急剧增加的驱动，例如OpenAI的“星际之门”项目预计每月消耗高达90万片晶圆，可能占据全球DRAM产量的近40%。与此同时，存储芯片产能正向高利润、高附加值方向倾斜，导致传统存储类别如DDR4供给紧张，其价格在不到一个月内累计上涨接近30%，半年涨幅超过200%。现货市场价格随之快速上行，资本市场反应强烈，美光股价近一月累计上涨约60%，铠侠与闪迪涨幅均超100%。芯片巨头上调产品报价，为中国企业带来了直接成本压力，同时涨价也伴随着供应的不稳定与交付周期延长，面对潜在的供应链安全风险，中国拥有自己的先进芯片技术“迫在眉睫”。

图 1 多国芯片巨头上调产品报价

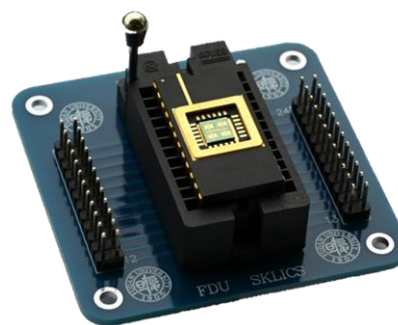


“破晓长缨”助力创新技术走向应用。2025 年 4 月复旦大学集成电路与微纳电子创新学院、集成芯片与系统全国重点实验室周鹏-刘春森团队在《自然》发表论文，提出“破晓”二维闪存原型器件，实现了 400 皮秒超高速非易失存储，比传统闪存快 100 万倍，是迄今最快的半导体电荷存储技术。2025 年 10 月 8 日，发表迄今最快二维闪存原型器件成果仅仅半年后，复旦大学团队就实现了全球首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。

图 2 “破晓 (PoX)” 皮秒闪存器件



图 3 封装后的二维-硅基混合架构闪存芯片

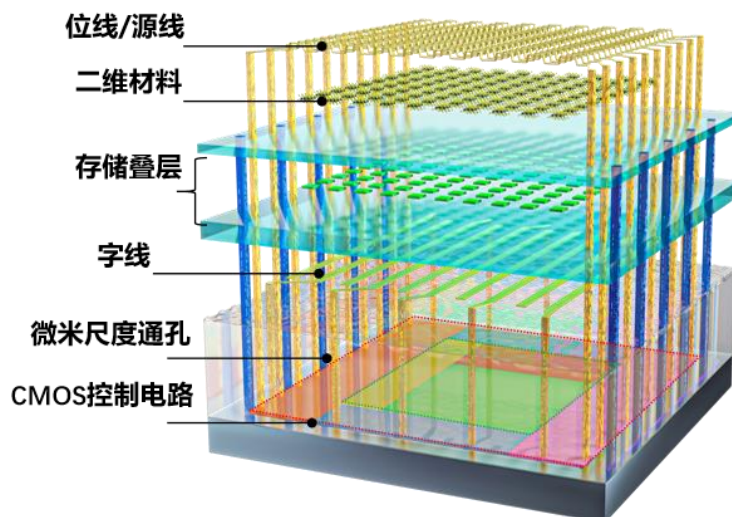


作为集成电路的前沿领域，二维电子学在近年来获得诸多关注，但研究者们最关心的问题莫过于“LAB to FAB（从实验室到工厂）”难题，也就是这项技术未来是否可以得到真正的应用。如何加速产业化进程，让二维电子器件走向功能芯片？周鹏-刘春森团队主动融入产业链，尝试从未来应用的终点出发，“从 10 到 0”倒推最具可能性的技术发展路径。

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补金属氧化半导体)，是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片，是电脑主板上的一块可读写的 RAM 芯片，CMOS 主要应用于计算机信息保存、数字影像、专业

的集成电路设计与制造领域。市场中的大部分集成电路芯片均使用 CMOS 技术制造，产业链较为成熟。团队认为，如果要加快新技术孵化，就要将二维超快闪存器件充分融入 CMOS 传统半导体产线，而这也能给 CMOS 技术带来全新突破。基于 CMOS 电路控制二维存储核心的全片测试支持 8-bit 指令操作，32-bit 高速并行操作与随机寻址，良率高达 94.3%。这也是迄今为止世界上首个二维-硅基混合架构闪存芯片，性能“碾压”目前的 Flash 闪存技术，首次实现了混合架构的工程化。

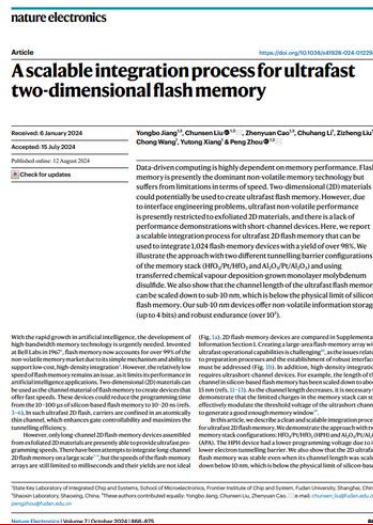
图 4 二维-硅基混合架构闪存芯片结构示意图



二维材料是一大类材料的统称，指的是在一个维度上材料尺寸减小到极限的原子层厚度，而在其他两个维度，材料尺寸相对较大。2004 年，K. S. Novoselov 等人在 *Science* 杂志发表文章，报道了通过机械剥离的方法从高取向的裂解石墨中获得了石墨烯，且证明了其独特优异的电学性质。自此之后，以石墨烯为代表的二维材料获得了快速的发展，新的二维材料如雨后春笋般涌现。得益于其原子层厚度方向上的量子局限效应，这些二维材料展示出与其对应的三维结构截然不同的性质，因此受到了科学界和工业界的广泛关注。面对摩尔定律逼近物理极限的全球性挑战，具有单个原子层厚度的二维半导体是目前国际公认的破局关键。

团队为了实现二维材料与 CMOS 集成又不破坏其性能，前期经历了 5 年的探索试错，在单个器件、集成工艺等多点协同攻关。团队的第一项集成工作发表于 2024 年的 *Nature Electronics*，在最理想的原生衬底上实现了二维良率的突破，这为他们在真实复杂的 CMOS 衬底上解决问题提供了基础。

图 5 团队 2024 年发表于 Nature Electronics 的文章



如何将二维材料与 CMOS 集成又不破坏其性能，是团队需要攻克的核心难题。CMOS 电路表面有很多元件，如同一个微缩“城市”，有高楼也有平地，高低起伏；而二维半导体材料厚度仅有 1-3 个原子，如同“蝉翼”般纤薄而脆弱，如果直接将二维材料铺在 CMOS 电路上，材料很容易破裂，更不用谈实现电路性能。团队决定从本身就具有一定柔性的二维材料入手，通过模块化的集成方案，先将二维存储电路与成熟 CMOS 电路分离制造，再与 CMOS 控制电路通过高密度单片互连技术（微米尺度通孔）实现完整芯片集成。正是这项核心工艺的创新，实现了在原子尺度上让二维材料和 CMOS 衬底的紧密贴合，最终实现超过 94% 的芯片良率。团队进一步提出了跨平台系统设计方法论，包含二维-CMOS 电路协同设计、二维-CMOS 跨平台接口设计等，并将这一系统集成框架命名为“长纓（CY-01）架构”。当传统硅基芯片的制程微缩逼近物理极限，二维半导体材料因其原子级厚度和优异电学特性，被认为是未来的突破方向，复旦大学团队的成果，率先证明了二维材料在成熟 CMOS 产线上实现高性能、高良率制造的可能性，为整个半导体产业的技术演进提供了一个切实可行的方案。

图 6 二维-硅基混合架构闪存芯片光学显微镜照片

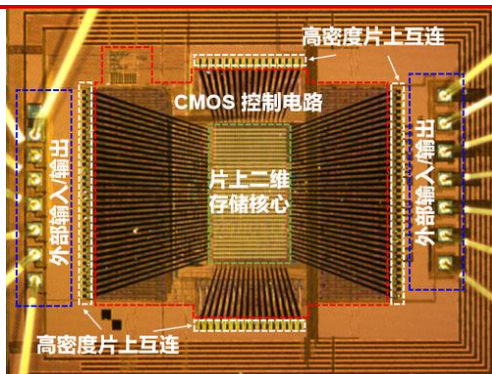
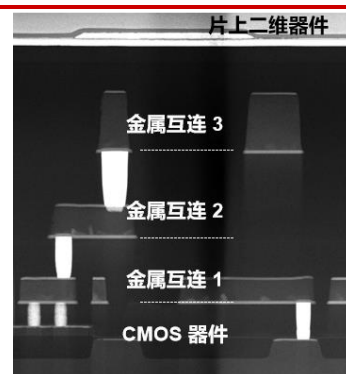


图 7 二维-硅基混合架构闪存芯片透射电子显微镜图



衔接起实验室成果与产业化需求，确保理论创新与应用转化能够“双腿并行”，是周鹏-刘春森团队在研究中相互交织的两条主线。从基础研究到工程化应用，团队已跨越最艰难一步，后续迭代进程将进一步加快。他们下一步计划建立实验基地，与相关机构合作，建立自主主导的工程化项目，并计划用 3-5 年时间将项目集成到兆量级水平，期间产生的知识产权和 IP 可授权给合作企业。团队研发的二维器件具有天然的访问速度优势，可突破闪存本身速度、功耗、集成度的平衡，未来或可在 3D 应用层面带来更大的市场机会。

展望二维-硅基混合架构闪存芯片的未来，复旦大学团队的技术突破使我国在下一代存储核心技术领域率先掌握了主动权，为人工智能、大数据等前沿领域提供更高速度、更低能耗的数据支撑。

2.3. 半导体行业会议前瞻：透视中国半导体发展新路径

（一）2025 年（第二届）湾区半导体产业生态博览会：构建全球半导体产业新生态

2025 年湾区半导体产业生态博览会（以下简称“湾芯展”）定于 10 月 15 日至 17 日在深圳会展中心（福田）举行。展会将同期举办湾区半导体大会，包括两大高端研讨会、一场开幕式暨半导体产业发展峰会及 20+ 场技术论坛，集结数百位行业领袖、专家学者、知名企业高管，共同擘画半导体产业的未来蓝图，打造年度思想盛宴，引领行业新风向。作为中国乃至全球半导体产业发展的重要风向标，本届湾芯展在深圳经济特区建立 45 周年的时代背景下召开，具有特殊的战略意义与产业价值。

在“2025 湾区半导体产业生态博览会”新闻发布会上，深圳市发展改革委主任郭子平表示，今年深圳出台的《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，自发布以来已惠及超 40 家企业和单位。深圳市在高端芯片、核心设备、关键材料上取得了一批丰硕成果。此外深圳在国庆期间发布了 2025 年第二批战略性新兴产业专项资金项目申报指南，包括半导体与集成电路、生物医药、高端医疗器械、大健康、新能源、安全节能环保等领域。针对半导体与集成电路领域，深圳一以贯之地支持设计流片、核心装备研发、先进封装水平提升、公共服务平台建设，以及国家项目配套等领域。

展会的两大高端研讨会包括：TOP20 高层战略研讨闭门会，将邀请半导体行业的顶尖决策者，包括 ASML、应用材料、科磊、泛林等全球半导体企业高管，共同探讨行业未来发展方向，从扶持政策、产能优化与供应链重构、技术突破与产业升级等关键维度出发，结合全球领先企业的技术洞察与战略经验，深入碰撞思想火花，共绘半导体行业的高质量发展蓝图；第九届国际先进光刻技术研讨会依托中国创新沃土，持续构建覆盖光刻设备、工艺制程、计量检测、掩模材料、计算光刻、系统协同优化及新型技术等全产业链的尖端技术对话平台。

图 8 TOP20 高层战略研讨闭门会



图 9 第九届国际先进光刻技术研讨会



针对 AI 掀起的芯片设计与半导体制造领域的产业变革，湾芯展开幕式暨半导体产业发展峰会将带来深度对话和前瞻性解读。峰会聚焦 AI 应用驱动下的芯片设计和半导体制造产业发展与市场动态，邀请半导体专家、国际和国内半导体头部企业的代表分享 IC 设计、晶圆制造和先进封装的最新技术和产业发展趋势。

另有 20+场技术论坛精彩纷呈，包括国际研讨会、产业论坛、颁奖盛典以及新品发布会等多元形式，议题涵盖光刻技术、人才、投融资、出海、人工智能（AI）等多维度核心议题，并聚焦 IC 设计、晶圆制造、先进封装、化合物半导体四大关键板块打造多场深度论坛，汇聚全球半导体行业专家、企业领袖和行业精英，共同探讨技术突破、产业趋势与合作机遇。

图 10 “湾芯展”部分技术论坛日程表

湾芯展 WESEMIBAY 湾区半导体大会	湾芯展 WESEMIBAY 湾区半导体大会	湾芯展 WESEMIBAY 湾区半导体大会
晶圆制造论坛 Wafer Manufacturing Forums - 半导体核心零部件论坛 - 集成电路材料产业发展峰会 - 国际半导体设备技术与工艺论坛（闭门） - 国际半导体材料与晶圆工艺论坛（闭门） 2025.10.15 → 10.16 深圳会展中心(福田) 主办单位：深圳市半导体与集成电路产业联盟、中国集成电路零部件创新联盟、深圳光电电子材料行业协会	化合物半导体论坛 Compound Semiconductor Forums - 化合物半导体产业发展高峰论坛 - 参观调研国家第三代半导体技术创新中心（深圳） - 化合物功率半导体技术及应用论坛（闭门） - 化合物半导体（SiC/GaN）赋能AR眼镜技术创新发展论坛 2025.10.15 → 10.17 深圳会展中心(福田) 主办单位：深圳市半导体与集成电路产业联盟、国家第三代半导体技术创新中心（深圳）（深圳市政府）、清华大学	先进封装论坛 Advanced Packaging Forums - Chiplet设计与异构集成技术论坛（闭门） - 光电芯片设计与封装技术论坛 - 先进封装工艺与材料论坛（闭门） 2025.10.15 → 10.16 深圳会展中心(福田) 主办单位：深圳市半导体与集成电路产业联盟
日程总表 晶圆制造论坛 国际半导体设备技术与工艺论坛（闭门） 2025.10.15 （全天） 半导体核心零部件论坛 2025.10.15 （上午） 集成电路材料产业发展峰会 2025.10.16 （全天） 国际半导体材料与晶圆工艺论坛（闭门） 2025.10.16 （下午）	日程总表 化合物半导体论坛 化合物半导体产业发展高峰论坛 2025.10.15 （上午） 化合物功率半导体技术及应用论坛 2025.10.15 （下午） 化合物半导体（SiC/GaN）赋能AR眼镜技术创新发展论坛 2025.10.15 （下午） 国际化合物半导体材料与工艺论坛 2025.10.16 （全天） 参观调研国家第三代半导体技术创新中心（深圳） 2025.10.17 （上午）	日程总表 先进封装论坛 Chiplet设计与异构集成技术论坛（闭门） 2025.10.15 （下午） 先进封装工艺与材料论坛（闭门） 2025.10.16 （全天） 光电芯片设计与封装技术论坛 2025.10.16 （上午）

值得关注的是，有“半导体领域的 DeepSeek”之称的新凯来（深圳市新凯来技术有限公司）旗下的几个子公司将参加此次展会，并发布新产品。新凯来旗下万里

眼技术有限公司将重磅发布自主研发的新一代超高速实时示波器，可将国产示波器性能提升 500%，实现多代产品的跨越，可应用于半导体行业、6G 通信、光通信、智能驾驶等领域。展会期间，万里眼将聚焦高频与高速芯片测试解决方案；超宽带光电连接测试解决方案；无线通信测试解决方案；下一代数字网络测试解决方案等四大解决方案，集中展示创新成果。新凯来的另一个子公司启云方也将在本届“湾芯展”中带来业内领先的重磅新品。

本届湾芯展的召开将进一步巩固深圳乃至大湾区在全球半导体产业中的战略地位，为区域产业注入新的动力与活力，吸引全球高端资源集聚，形成更加完善的产业生态与创新环境，有助于中国半导体产业在全球新格局中找准定位、发挥优势、补齐短板，提升中国半导体产业的全球竞争力与创新力。

（二）第三届第三代半导体产业合作大会：聚力“芯”发展，共建“芯”生态

第三届第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大赛将于 2025 年 10 月 24-25 日在江苏盐城隆重举行。本次大会以“聚力‘芯’发展 共建‘芯’生态”为主题，由盐城市人民政府和中国科学院半导体研究所共同主办，第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）等机构承办。

图 11 第三代半导体产业技术创新战略联盟简介



本届大会吸引众多顶尖专家参与，延续往年高规格、专业化的嘉宾阵容。在学术与研究领域，大会吸引多位领域专家参与指导，邀请了中国科学院半导体所原副所长杨富华进行特邀报告，另有福州大学、厦门大学等多名学界教授出席分享。产业界的参与是本次大会的另一大亮点，会议吸引了京东方、安徽芯塔等龙头企业高管齐聚，将从半导体领域的业界角度分享产业发展现状与未来趋势。

图 12 第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大赛日程安排

第三代半导体产业合作大会	第三代半导体引领下的新市场与新应用研讨会
10月25日（周六）	10月25日（周六）
09:30-09:45 领导致辞 09:45-09:55 盐城高新区产业招商推介 09:55-10:00 盐城半导体集成技术研究院进展及合作发布 10:00-10:05 第三届长三角第三代半导体创新创业大赛获奖项目颁奖 10:05-10:10 CASA 标准发布 10:10-10:15 项目签约 特邀报告 主持人：杨富华 第三代半导体产业技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国科学院半导体所原副所长 10:15-10:40 新型显示技术现状与战略部署 郭大良 福州大学教授、俄罗斯自然科学院外籍院士、科技部“战略性先进电子材料”重点专项总体专家组副组长 10:40-11:00 构建8吋的SiC功率半导体 刘红耀 长飞先进半导体有限公司首席科学家/高级副总裁 11:00-11:20 碳化硅高压电力电子器件及应用 杨 雷 中国电科院电力电子所副总工程师、教授高级工程师 圆桌对话 议题：新形势下第三代半导体如何破局发展 11:20-12:00 黄福良 国德汽车副总经理、研究院院长 郑晨金 华润微电子功率器件事业部技术创新中心总监 李隆正 上海瀚薪科技有限公司总经理 倪伟江 安徽芯塔电子科技有限公司总裁 谢相伟 厦门市芯耀显示科技有限公司副总经理 王江波 京东方华灿光电副总裁、CTO	功率电子应用领域的突围 14:00-14:20 共建化合物半导体创新生态系统 吴 琼 九峰山实验室生态系统部部长 14:20-14:40 第三代半导体器件在新能源汽车领域的应用进展及发展趋势 李隆正 上海瀚薪科技有限公司总经理 14:40-15:00 车用碳化硅功率器件市场分析与展望 倪伟江 安徽芯塔电子科技有限公司总裁 15:00-15:20 NPN结构SiC MOSFET的材料生长及器件制备 刘兴盼 中国科学院半导体研究所研究员、江苏汉印机电科技股份有限公司项目负责人 15:20-15:40 休息 光电应用领域的升级 15:40-16:00 题目待定 黄 凯 厦门大学物理科学与技术学院副院长、嘉庚创新实验室未来显示技术研究院副院长 16:00-16:20 半导体显示技术发展展望 王国防 中国科学院半导体所研究员、扬州中科半导体照明有限公司特聘专家 16:20-16:40 第三代半导体材料发展“芯”机遇 王江波 京东方华灿光电副总裁、CTO 16:40-17:00 应用牵引，协同推进 谢相伟 厦门市芯耀显示科技有限公司副总经理

本次大会选址盐城，反映了长三角地区第三代半导体产业布局的新趋势。盐城作为长三角北部的重要城市，正积极把握半导体产业发展机遇。我们认为，第三届第三代半导体产业合作大会暨第三届长三角第三代半导体创新创业大会将通过促进技术交流、产业对接与区域协同，为我国第三代半导体产业高质量发展注入新动能，为构建自主可控、安全可靠的半导体产业体系贡献重要力量。

（三）2025 中国半导体先进封装大会：聚焦晶圆制造与先进封装

2025 中国半导体先进封装大会暨中国半导体晶圆制造大会将于 10 月 22 日，在昆山金陵酒店 3 楼盛大启幕。作为半导体产业链两大核心支柱，晶圆制造与先进封装的协同发展正重塑行业格局。当前，国内晶圆制造在关键设备与工艺上仍存技术短板，先进封装虽突破传统制程极限，却面临产业链自主可控的挑战，亟需行业合力破局。

本次大会汇聚全球半导体领域专家学者、企业领袖，围绕“晶圆制造是根基，先进封装是突破方向”核心议题展开深度研讨。现场将重磅发布新型晶圆制造工艺、Chiplet 架构等前沿成果，同时通过主题论坛直击设备受限下的效率提升、先进封装技术瓶颈等行业痛点，凝聚产学研用多方智慧。

会议精心打造主题演讲、分论坛研讨、展览展示三大核心板块。在主题演讲环节，行业权威将解读技术趋势与政策动向；分论坛中，与会者可针对细分领域展开深度对话；展览展示区则集中呈现国内外领先的产品与技术方案，为企业搭建技术与商业合作的桥梁。

这场会议不仅是技术思想的碰撞场，更是产业升级的助推器。大会将通过深入探讨晶圆制造与先进封装领域的前沿进展，明晰技术演进路线与突破方向。特别是在 2.5D/3D 集成、Chiplet 架构、宽禁带半导体材料等关键领域，大会的讨论将为产学研各界的研发方向提供重要参考，通过深度资源对接与创新生态构建，为我国半导体产业注入新动能。

图 13 2025 中国半导体先进封装大会暨中国半导体晶圆制造大会演讲企业及议题

公司名称	议题	演讲企业	演讲议题	演讲企业	演讲议题
珠海天成先进半导体科技有限公司	突破算力困局：先进封装技术助力算力迭代	格创东智（武汉）科技有限公司	从自动化到自主化：AI赋能先进封装CIM的新世代演进之路	南江实验室	高深宽比玻璃通孔(TGV)制造关键技术
珠海硅芯科技有限公司	聚焦2.5D/3D先进封装EDA平台——后端全流程设计、仿真与验证协同创新实践	湖南越厚先进半导体有限公司	突破系统瓶颈：先进封装驱动下的多芯片协同设计与优化	成都奕成科技股份有限公司	AI大芯片封装发展趋势及板级解决方案
苏州智程半导体科技股份有限公司	电镀在先进封装中发展历程以及未来的挑战	北京电子量检测装备有限公司	先进封装量测技术革新：3D高精度解决方案赋能异构集成时代V	天芯互联科技有限公司	Chiplet异构集成封装技术
江苏芯德半导体科技股份有限公司	超高端封装技术为高速运算芯片带来多方位解决方案	江苏爱砂半导体科技有限公司	探讨如何通过银烧结技术提升封装的长期可靠性及散热性能	奕丰科技(宁波)有限公司	先进封装CeIP介绍：AI芯片先进封装的另类选择
鑫业诚智能装备(无锡)有限公司	半导体封装工艺3D AOI检测技术研究与应用	中国电子科技集团公司第二研究所	先进封装发展趋势与设备研究现状		
昂卜半导体	HPC和CPO的2.5D/3D封装解决方案	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	8吋&12吋晶圆级封装技术分享	深圳电通伟创微电子股份有限公司 珠海海纳航科技有限公司	半导体技术的发展给中国带来的机遇
板石智能科技（深圳）有限公司	干涉原理在先进封装量测中的应用与案例	芯和半导体科技（上海）股份有限公司	集成系统 EDA 加速Chiplet 先进封装设计与应用	爱德克斯(合肥)科技有限公司	新型薄膜设备在晶圆制造和先进封装工艺的应用
锐杰微科技	面向云上系统的先进封装技术与创新应用	苏州尊恒半导体科技有限公司	尊恒全球首条面板级封装设备线对行业的意义与中国的贡献	上海芯上微装科技股份有限公司	先进封装技术发展及光刻机技术演进
		深圳市亿天净化技术有限公司	洁净环境对半导体晶圆、先进封装制造良率影响分享——论：洁净室大环境、微环境部门沟通的重要性	江西萨瑞微电子有限公司	碳化硅MOSFET工艺与硅基MOSFET的区别和难点
甬江实验室	异构集成驱动下的微纳制造关键技术挑战与发展趋势	三叠纪（广东）科技有限公司	TGV3.0技术助力玻璃基2.5D&3D先进封装	中国电子系统工程第二建设有限公司	半导体产业建设投资分析要点
				北一半导体科技(广东)有限公司	概述中
				浙江芯栖微电子科技有限公司	芯“链”协同，“植”向未来——芯栖微在显示驱动芯片先进封装的国产化实践

（四）2025 第七届人工智能应用产业博览会：助力构建 "AI + 跨行业" 解决方案

2025 第七届人工智能应用产业博览会（简称：ACE 2025）将于10月10-12日在上海新国际博览中心盛大举行。本届展会以"All in AI"为主题，首次系统性聚焦人工智能在消费电子、智慧家居、元宇宙三大核心领域的创新成果，通过2万m²展区构建 AI 技术与产业融合的全景生态。

与此同时，2025半导体显示产业年会将在2025第七届人工智能应用产业博览会（ACE2025）上举办。本届年会以“技术突破与生态协同”为主题，汇聚半导体显示产业链上下游龙头企业、科研机构及行业权威专家，共同围绕Mini LED背光与MLED直显、AR/VR微显示、国产化供应链等关键议题展开深度研讨。在2025半导体显示产业年会期间，将重磅举办《2025 MLED显示产业白皮书》发布仪式，本次白皮书以“1+4+N”为核心理念，通过一套白皮书、四本分册深度解构Mini LED背光、MLED直显、硅基微显示、车载显示四大核心赛道，系统梳理N家产业链龙头及标杆企业最新技术动态和产业布局，为从业者提供从技术攻坚到商业落地、从产业现状到市场趋势的全景导航。本次会议旨在搭建技术交流、资源对接、标准共建的高效平台，加速技术从实验室到商业化的跨越，助力中国在全球半导体显示产业中占据领先地位。

图 14 2025 半导体显示产业年会亮点内容



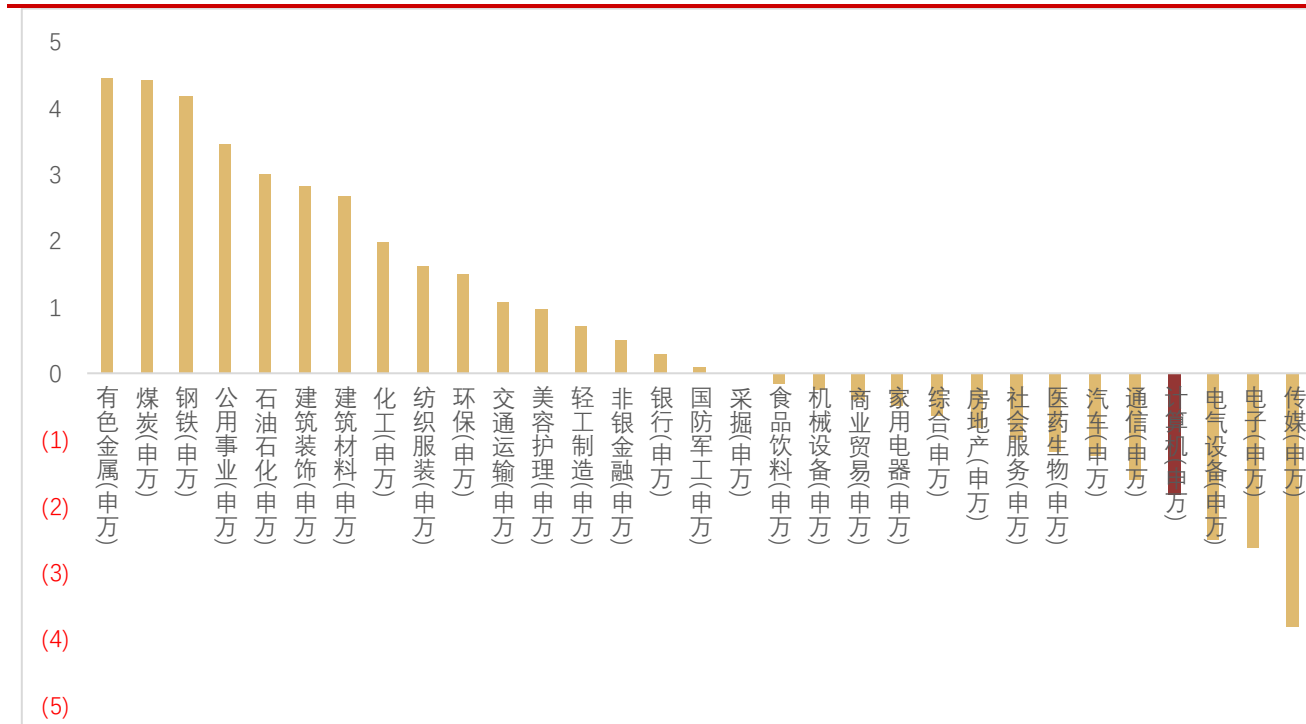
资料来源：2025 第七届人工智能产业应用博览会官网，华西证券研究所

3. 本周行情回顾

3.1. 行业周涨跌及成交情况

本周计算机位列第28位。本周沪深300指数下跌0.51%，申万计算机行业周下跌1.83%，低于指数1.32个pct，在申万一级行业中排名第28位。

图 15 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (本周)



2025年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第10名，高于指数8.36个百分点。年初至今申万计算机行业累计上涨25.69%，在申万一级31个行业中排名第10位，沪深300上涨17.33%，高于沪深300指数8.36个百分点。

图 16 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (2025 年初至今)

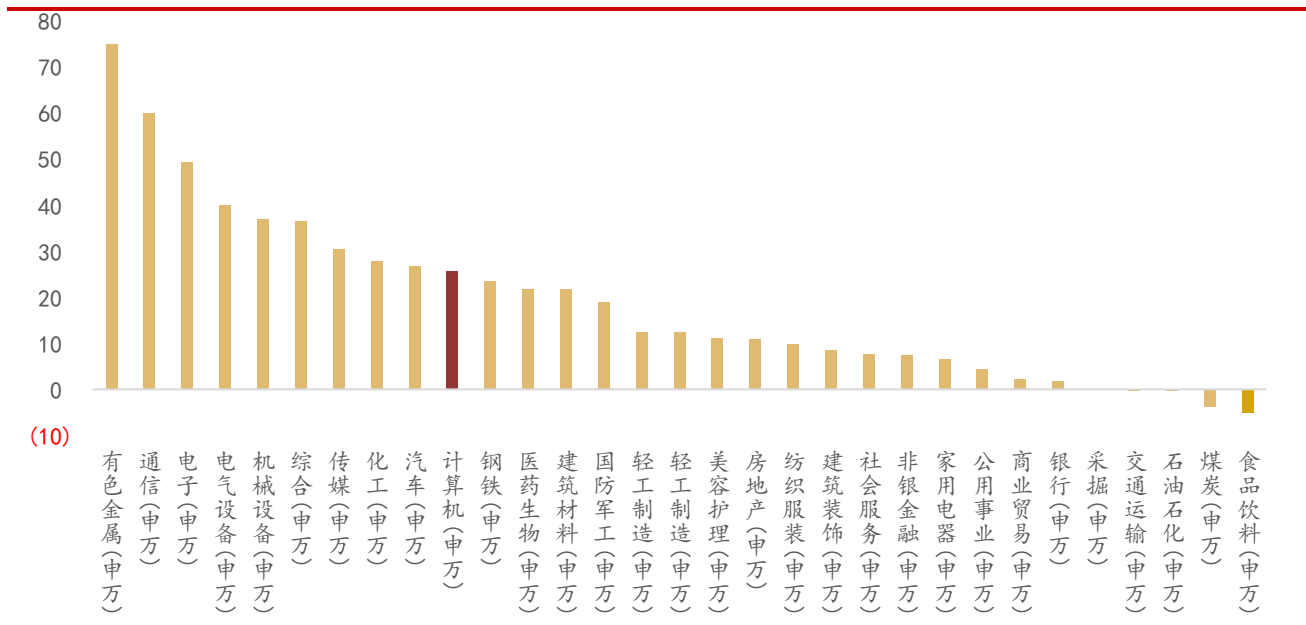
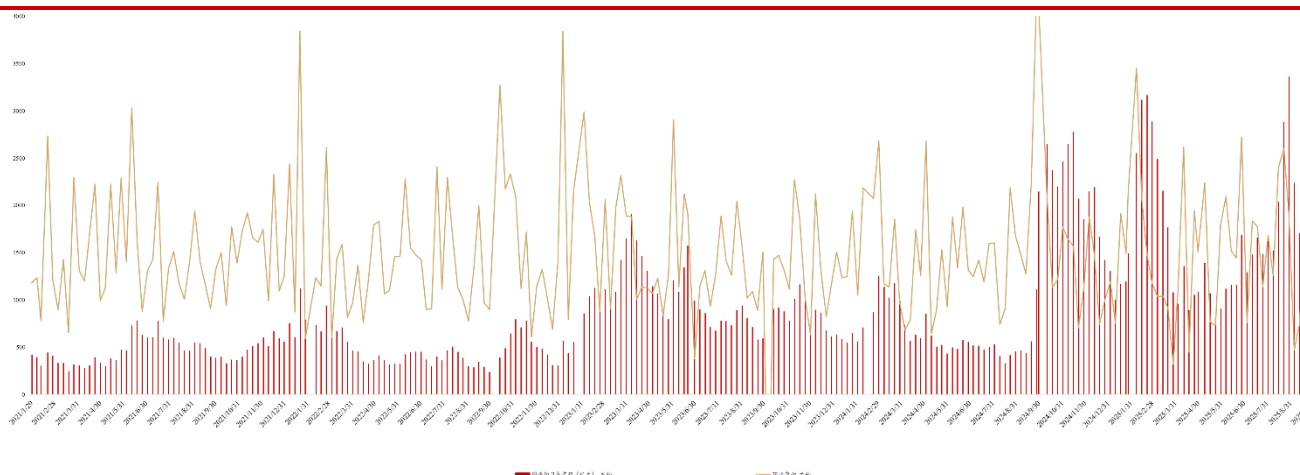


图 17 计算机行业周平均日成交额（亿元）



3.2. 个股周涨跌、成交及换手情况

本周计算机板块表现出下跌趋势，整体交投相对活跃。321只个股中，87只个股上涨，210只个股下跌，24只个股持平。上涨股票数占比27.10%，下跌股票数占比65.42%。行业涨幅前五的公司分别为：中望软件、品茗科技、竞业达、中威电子、安联锐视。跌幅前五的公司分别为：恒为科技、荣科科技、每日互动、佳创视讯、深信服。

图 18 申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）

中望软件	16.52
品茗科技	14.31
竞业达	11.08
中威电子	10.83
安联锐视	10.44

图 19 申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）

-16.23	恒为科技
-15.14	荣科科技
-10.88	每日互动
-9.76	佳创视讯
-9.13	深信服

从周成交额的角度来看，浪潮信息、中科曙光、海康威视、科大讯飞、指南针位列前五。从周换手率的角度来看，中电鑫龙、初灵信息、同有科技、中威电子、先进数通位列前五。

图 20 申万计算机行业日均成交额前五（亿元）

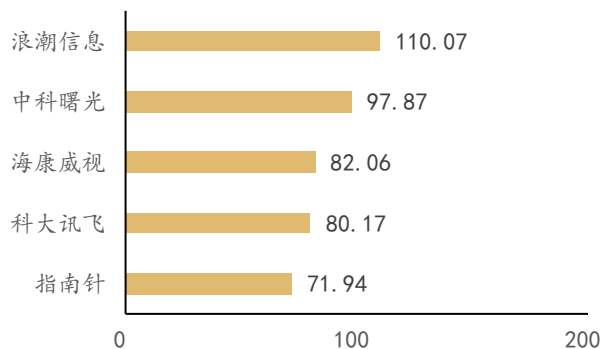
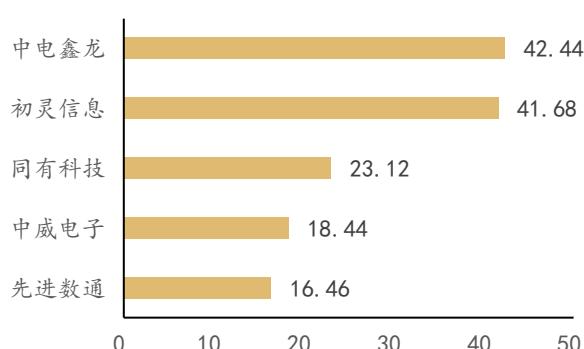


图 21 申万计算机行业日均换手率前五（%）



3.3. 核心推荐标的行情跟踪

本周板块整体呈现普遍下跌的情况下，我们的 8 只核心推荐标的 1 只上涨。其中涨幅最大的为中望软件，涨幅为 16.52%，跌幅最大的为深信服，跌幅为 9.13%。

图 22 本周核心推荐标的行情

序号	股票代码	公司简称	总市值 (亿元)	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	日均成交额 (亿元)	换手率 (%)
1	300674.SZ	宇信科技	174.75	24.82	-1.59	3.67	2.07
2	002230.SZ	科大讯飞	1293.85	55.97	-0.14	80.17	6.33
3	300682.SZ	朗新集团	205.79	19.05	-2.16	3.34	1.65
4	600570.SH	恒生电子	644.59	34.02	-1.45	20.39	3.09
5	300454.SZ	深信服	481.12	114.04	-9.13	12.02	3.59
6	600588.SH	用友网络	522.80	15.3	-2.05	21.94	4.07
7	688083.SH	中望软件	150.08	88.5	16.52	8.52	5.73
8	300496.SZ	中科创达	340.65	73.99	-4.75	25.38	8.94

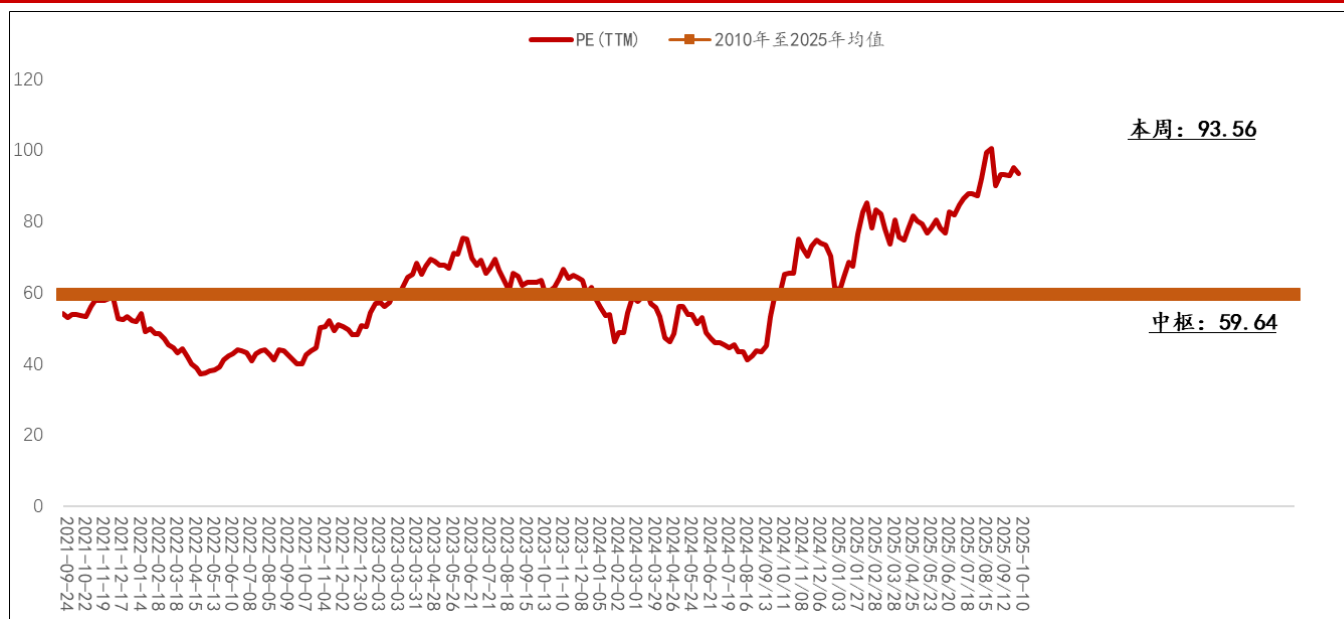
注：1、区间收盘价指本周最后一个交易日的收盘价，复权方式为前复权。

2、朗新集团为华西计算机 & 通信联合覆盖

3.4. 整体估值情况

从估值情况来看，SW 计算机行业 PE (TTM) 从 2018 年低点 37.60 倍升至 93.56 倍，高于 2010-2025 年历史均值 59.64 倍，行业估值高于历史中枢水平。

图 23 申万计算机行业估值情况（2010 年至今）



4. 本周重要公告汇总

1、股份回购

【工业富联】关于股份回购进展公告

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 769.74 万股，占总股本的 0.04%，回购价格区间为 18.40 元/股至 19.84 元/股，累计使用资金 147,089,384.00 元（不含交易佣金、过户费等）。回购用途为减少注册资本。

2、对外投资

【索辰科技】关于全资子公司购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司 55%股权的公告

上海索辰信息科技股份有限公司（证券代码：688507）全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以人民币 7,425 万元购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司股东王晋升和陆延涛合计持有的 55%股权。本次交易资金来源为自有资金或银行借款，采用收益法评估，昆宇蓝程股东全部权益评估值为 13,500 万元，增值率达 667.82%。交易完成后，数字科技将持有昆宇蓝程 55%的股权，并将其纳入合并报表范围。

【慧博云通】关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司 67.91%股份，并向实际控制人余浩先生及其控制的深圳申晖控股有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公

司发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。

3、股票激励

【普联软件】关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

普联软件股份有限公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分限制性股票作废的议案》，对 2024 年限制性股票激励计划已经授予尚未归属的股票授予数量由 390 万股调整为 546 万股、授予价格（含预留授予）由 11.00 元/股调整为 7.75 元/股。

4、权益分派

【御银股份】2025 年半年度权益分派实施公告

2025 年半年度利润分配方案具体内容：以公司总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.02 元（含税），共计派发现金股利金额 1,522,382.58 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至下一年度。

5、其他事件

【国联股份】关于控股子公司增资扩股并引入投资者进展暨完成工商变更登记的公告

国联股份控股子公司卫多多完成 A1 轮增资扩股，引入珠海格金九号和珠海格金三号股权投资基金，合计增资 2 亿元人民币。其中，99.5024 万元计入注册资本，剩余 19,900.4976 万元计入资本公积。增资后，卫多多注册资本由 3,000 万元增至 3,099.5024 万元，仍为公司控股子公司。

5. 本周重要新闻汇总

1. 阿里巴巴 AI 叙事强劲

国家标准化管理委员会发布《关于下达 2023 年第四批推荐性国家标准计划及相阿里巴巴正站在人工智能新征程的起点，阿里云定位全栈人工智能服务商，收入加速增长具备确定性，中长期利润率有较大提升空间。看好该公司的大模型+云计算+自研芯片布局，同时 AI 赋能其他业务的效果逐步显现。

（来源：wind）

2. 人类有望在未来 10 至 20 年内在太空建造千兆瓦级数据中心

亚马逊创始人兼执行董事长杰夫·贝佐斯近日在意大利科技周都灵站发表演讲时预测，人类有望在未来 10 至 20 年内在太空建造千兆瓦级数据中心。他指出，太空环境中持续可用的太阳能将赋予这些数据中心超越地球同类设施的潜力。贝佐斯还将当前人工智能的快速发展与 21 世纪初的互联网浪潮相类比，认为尽管存在投机泡沫的风险，仍应对技术发展保持乐观态度。

(来源: wind)

3. 特斯拉官宣年底推第三代人形机器人

马斯克在社交平台 X 上传了一段特斯拉机器人 Optimus 和人类工作人员“过招”练功夫的视频。视频中，Optimus 的背部系有一根牵引绳，除此之外并无其他束缚，其紧跟工作人员的动作，并实时作出动作回应。值得一提的是，就在几日前，TeslaAI 微博官方账号发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划 2025 年底推出第三代，并在 2026 年开始量产。

(来源: wind)

4. 苹果下架大量山寨 OpenAI Sora 应用

这些山寨应用为了增加可信度，有的直接在图标中盗用 OpenAI 的官方标志，有的则在副标题中捆绑谷歌的 Veo 3 模型，来诱导用户通过应用内购买或高额的周度订阅服务付费。在媒体曝光后，苹果公司已迅速采取行动，为遏制骗局的进一步蔓延，目前报道中提及的这些山寨应用已被从 App Store 下架，或被强制恢复其原始名称。

(来源: TechWeb)

5. ChatGPT 代码泄露内置私信功能，未来可直接与好友聊天

OpenAI 正推动 ChatGPT 向社交平台转型，正在测试内置“私信”(Direct Messages)功能，并配套开发用户名与个人资料系统，支持用户之间直接交流。该功能如果落地，那么将彻底改变 ChatGPT 的产品定位，从一个单纯的大型语言模型交互工具，转变为一个具备社交属性的 AI 平台。

(来源: IT 之家)

6. 构建完整国产化软硬件生态链：象帝先 R1900 专业显卡与联想开天 P5h G1t 工作站成功适配

近日，象帝先计算技术公司旗下的 16GB GDDR6 高性能显卡 R1900 与联想开天 P5h G1t 国产工作站完成全面适配。此举标志着国产化软硬件协同解决方案迈上新台阶，双方构建了从整机硬件到图形渲染引擎(如 Z-Engine)的完整国产软硬件生态链，为专业图形图像处理、工业设计和数字孪生等领域提供了更安全、高效的全栈解决方案。

(来源: IT 之家)

7. OpenAI 与 AMD 达成战略合作，将大量采购 AMD 算力芯片并入股约 10%

OpenAI 与 AMD 宣布达成一项深度战略合作。根据协议，OpenAI 将在未来数年内部署总计 6 吉瓦 (GW) 算力的 AMD Instinct 系列 GPU，首批 1 吉瓦计划于 2026 年下半年使用 MI450 芯片进行部署。同时 AMD 向 OpenAI 发行了认股权证，允许其以极低的行权价认购最多 1.6 亿股 AMD 股票，约占 AMD 流通股的 10%。这些权证的归属与芯片部署进度及 AMD 的股价里程碑挂钩，从而将双方利益深度绑定。

(来源: TechWeb)

8. 谷歌“Nano Banana”图像 AI 模型正式开放商用：同步新增批量处理、自定义长宽比功能

谷歌旗下图像生成模型 Gemini 2.5 Flash Image (代号 Nano Banana) 已于 2025 年 10 月 7 日正式开放商用，并新增批量处理功能及 10 种自定义长宽比支持。该模型自 8 月底预览以来，在 Gemini AI 平台已生成超 50 亿张图片，用户可通过多种方式访问。商业化后，其定价为每 100 万输出 Token 收费 30 美元，平均每张图片生成成本约 0.039 美元。

(来源: IT 之家)

9. Meta 开源 OpenZL 无损压缩框架，号称可显著提升结构化数据压缩速度

Meta 开源 OpenZL 无损压缩框架，其核心创新在于能感知数据结构。测试显示，它对结构化数据的压缩比达 2.06，压缩速度约 340 MB/s，均优于 zstd-3 和 xz-9 等传统方案。该框架使用通用解压器，无需额外插件即可还原数据。

(来源: IT 之家)

10. ChatGPT 变身 App Store，「对话即应用」时代到了

OpenAI 宣布 Booking、Canva、Spotify 等应用正式入驻 ChatGPT。用户现可直接在对话中通过自然语言指令 (如“Spotify，制作歌单”) 调用这些服务，实现无需跳转的沉浸式操作。此举基于 Model Context Protocol 开放标准，旨在将 ChatGPT 从工具升级为“AI 门户”。未来数月，Uber、DoorDash 等服务将加入，进一步拓展其生态边界。

(来源: 极客公园)

11. 中科蓝讯：依托现有芯片技术底座，为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量

中科蓝讯基于 RISC-V 架构自主研发高性能 CPU 内核，开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片；IP 基本自研，自主可控能力强，可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用 CPU+DSP+NPU 多核架构，满足音频 AI 算法开发，可连接云端使用大模型 AI 能力，同时支持 Hi-Res 及 Hi-Res Wireless 双金标。

(来源: 人民财讯)

12. Gemini 2.5 Pro 能力再进化：谷歌推出专用计算机操作模型，让 AI 智能体丝滑接管 UI 交互

谷歌正式推出 Gemini 2.5 计算机使用模型。这是一款基于 Gemini 2.5 Pro 视觉理解与推理能力构建的专用模型，旨在赋予 AI 智能体与图形用户界面直接交互的能力——就像人类一样进行点击、打字和滚动操作。安全上，谷歌采取了模型内置安全特性和开发者安全控制，以应对滥用、意外行为及诈骗等风险。

（来源：新浪财经）

13. 马斯克旗下的 xAI 有望融资 200 亿美元，英伟达是股权投资者之一

马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 有望融资 200 亿美元，超出最初计划的融资规模，英伟达是股权投资者之一。本次融资分为约 75 亿美元的股权融资和最高 125 亿美元的债务融资，并将与英伟达图形处理器 (GPU) 绑定，xAI 计划在其位于孟菲斯的“Colossus 2”数据中心使用这些处理器。英伟达与 xAI 发言人暂未回应。

（来源：36Kr）

14. 谷歌收购 MIT 衍生量子计算初创企业 Atlantic Quantum

谷歌量子计算部门宣布已完成对 MIT（麻省理工学院）衍生量子计算初创企业 Atlantic Quantum 的收购，后者团队加入谷歌。Atlantic Quantum 专注于开发高度集成的量子计算硬件，该企业的模块化量子芯片堆栈集成技术将帮助 Google Quantum AI 更有效地扩展超导量子比特硬件，并加速其迈向大型纠错量子计算机和现实世界应用的进度。

（来源：IT 之家）

15. OpenAI 拟在加拿大布局人工智能数据中心产能

OpenAI 全球事务首席官 Chris LeHane 表示，公司有意在加拿大获取数据中心容量，并宣称能够助力加拿大构建主权人工智能能力。Chris LeHane 称，公司已在德国、挪威等国宣布多项举措，涵盖人工智能基础设施建设或算力采购等方面，目前正在加拿大探索类似合作模式。

（来源：财联社）

16. 蚂蚁发布万亿参数旗舰模型 Ling-1T 并开源

蚂蚁集团发布万亿参数大模型 Ling-1T。该模型在代码生成、数学推理等多个高难度测试中领先，并以更少 Token 在 AIME 数学测试中准确率超越 Gemini-2.5-Pro。Ling-1T 支持 128K 上下文窗口，已开源供开发者体验。

（来源：TechWeb）

17. 全球首颗，复旦团队研发出二维-硅基混合架构闪存芯片

复旦大学周鹏-刘春森团队在《自然》发表研究成果，成功研发出全球首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。该研究通过创新的“长纓”架构，将二维超快闪存器件与成熟 CMOS 工艺深度融合，攻克了二维材料与硅基电路集成的世界性难题。这项成果为新一代颠覆性信息技术缩短应用周期提供了成功范例，有望推动信息技术迈入全新高速时代。

(来源: Wind)

18. 导远科技车规级 MEMS IMU 芯片获自主可控认定

导远科技研发的 6 轴车规级 MEMS IMU 惯性传感器芯片 GST80, 通过工信部电子五所权威认证, 确认为自主可控芯片。这标志着我国在高性能车规 IMU 芯片领域实现关键突破, 建立了从设计到封装测试的全流程自主掌控能力。作为业内首款同时满足车规品质、功能安全与自主可控的单片全自由度 MEMS IMU, 该芯片将为智能汽车、机器人等产业提供核心自主的感知基础, 推动产业创新发展。

(来源: Wind)

19. 美国汽车安全监管机构对特斯拉 FSD 启动调查, 涉及近 290 万辆汽车

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 披露, 缺陷调查办公室 (ODI) 现启动对特斯拉全自动驾驶功能 (FSD) 的调查, 涉及特斯拉车辆在 FSD 模式下行驶的交通法规违规行为, 包括闯红灯及在公共道路上逆向行驶, 预计涉及 2,882,566 辆装备有该功能的车辆。

(来源: 36Kr)

20. GitHub 全面迁移至微软 Azure 云平台

微软宣布将在未来两年内将其代码托管平台 GitHub 的基础设施从自建数据中心全面迁移至 Azure 云平台。这项重大调整旨在应对人工智能和 Copilot 业务快速增长带来的技术挑战。GitHub 首席技术官 Vladimir Fedorov 表示, 现有数据中心容量已接近极限, 迁移至 Azure 是平台持续发展的关键举措

(来源: Wind)

21. 银河通用机器人完成新一轮 11 亿融资

银河通用宣布完成由宁德时代领投的 11 亿元人民币新一轮融资, 两年累计融资超过 24 亿元。今年 3 月公司发布人形机器人智慧零售方案, 单店 1 天即可部署, 支持 5000 种商品全流程智能管理, 目前北京已有近十家门店常态化运营, 预计年内将在全国范围内实现百店规模化投用。

(来源: IT 之家)

22. NBA 中国与阿里云达成合作, 将开发「NBA 篮球大模型」

NBA 中国与阿里云宣布战略合作, 旨在通过科技提升篮球运动的参与度和吸引力。双方将共同开发人工智能技术, 包括 NBA 篮球大模型, 以优化赛事体验, 增强球迷和球员的互动, 推动篮球运动的普及与发展。

(来源: TechWeb)

23. 《时代》杂志公布年度 300 大发明: 宇树、DeepSeek 均上榜

《时代》称，从无人机到自动驾驶汽车，如今的大多数机器人并不是科幻作品中设想的人形机器人，一个例外则是来自宇树科技的R1。当前，人类共有300个关节，而R1有26个，使其能够完成拳击、跑步、翻跟头等复杂动作。时代》称，今年年初，DeepSeek-R1先进推理模型横空出世，堪称在AI领域打响了“响彻世界的第一枪”。

（来源：快科技）

24. 电信、字节跑步进场，AI 制药又迎来一批新“追求者”

在“服贸会”上，中国电信携手拜耳、恒瑞等全球知名药企共同发布“AI 药物研发公共服务平台”。几乎同一天，字节跳动 Protenix 团队在 AI 制药的研究上也迎来突破性进展——PXDesign 系统较 AlphaProteo 等先进方法提升了 2~6 倍的性能。接连两个重磅消息，很快点燃了行业热情，使得 AI 制药再度站上风口。

（来源：钛媒体）

25. 微软 Azure 推出全球首个 GB300NVL72 超级计算集群

微软云计算部门 Azure 近日宣布，正式上线全球首个生产级英伟达 GB300NVL72 超级计算集群。基于此集群架构的 NDv6GB300VM 虚拟机将承载 OpenAI 工作负载，显著提升大规模 AI 训练效率。微软表示，未来将持续扩展算力布局，进一步强化其在生成式 AI 基础设施领域的领先地位。

（来源：Wind）

26. OpenAI 向欧盟“告状”：苹果谷歌等科技巨头或成 AI 创新“拦路虎”

OpenAI 已正式向欧盟委员会表达对苹果、微软、谷歌等美国科技巨头市场地位的担忧，称这些企业可能对 AI 初创公司的发展造成严重阻碍。但欧盟委员会尚未就 OpenAI 的担忧与提议作出公开回应。而此次事件已凸显出 AI 行业日益凸显的市场竞争问题——如何平衡巨头的技术优势与行业创新活力、如何通过合理监管保障市场公平竞争，已成为全球监管机构面临的重要课题。

（来源：极客网）

6. 历史报告回顾

一、 云计算（SaaS）类：

- 1、云计算龙头深度：《用友网络：中国企业级 SaaS 脊梁》
- 2、云计算龙头深度：《深信服：IT 新龙头的三阶成长之路》
- 3、云计算龙头深度：《深信服：从超融合到私有云》
- 4、云计算行业深度：《飞云之上，纵观 SaaS 产业主脉络：产业-财务-估值》
- 5、云计算行业深度：《海外篇：海外 SaaS 启示录》
- 6、云计算行业深度：《港股篇：挖掘最具成长性的港股 SaaS 标的》
- 7、云计算动态跟踪之一：《华为关闭私有云和 Gauss DB 意欲何为？》

- 8、云计算动态跟踪之二：《阿里云引领 IaaS 繁荣，SaaS 龙头花落谁家？》
- 9、云计算动态跟踪之三：《超越 Oracle，Salesforce 宣告 SaaS 模式的胜利！》
- 10、云计算动态跟踪之四：《非零基式增长，Salesforce 奠定全球 SaaS 标杆地位》

二、 金融科技类：

- 1、证券 IT 2B 龙头深度：《恒生电子：强者恒强，金融 IT 龙头步入创新纪元》
- 2、证券 IT 2C 龙头深度：《同花顺：进击-成长的流量 BETA》
- 3、银行 IT 龙头深度：《宇信科技：拐点+弹性，数字货币新星闪耀》
- 4、银行 IT 行业深度：《分布式，新周期》
- 5、万亿蚂蚁与产业链深度研究之一：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》
- 6、金融科技动态跟踪之一：《创业板改革细则落地，全面催化金融 IT 需求》
- 7、金融科技动态跟踪之二：《蚂蚁金服上市开启 Fintech 新时代》
- 8、金融科技动态跟踪之三：《开放三方平台，金融科技创新有望迎来第二春》

三、 数字货币类：

- 1、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》
- 2、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》
- 3、数字货币动态跟踪之一：《官方首次明确内测试点，数字货币稳步推进》
- 4、数字货币动态跟踪之二：《合作滴滴拉开 C 端场景大幕》
- 5、数字货币动态跟踪之三：《BTC 大涨带来短期扰动，DCEP 仍在稳步推进》
- 6、数字货币动态跟踪之四：《启动大规模测试，《深圳行动方案》加速场景探索》
- 7、数字货币动态跟踪之五：《建行数字货币钱包短暂上线，测试规模再扩大》
- 8、数字货币动态跟踪之六：《深圳先行，数字货币红包试点验证 G 端场景》

四、 工业软件类：

- 1、工业软件龙头深度：《能科股份：智能制造隐形冠军，行业 know-how 铸就长期壁垒》
- 2、工业软件龙头深度：《中望软件：进军中国工业软件的“无人区”》
- 3、工业软件行业深度：《总篇：工业软件，中国制造崛起的关键》
- 4、工业软件动态跟踪之一：《三年行动计划出台，工业互联网大风再起》
- 5、工业软件动态跟踪之二：《工业软件为“基”，实现数字化转型》

五、 其他类别：

- 1、办公软件龙头深度：《福昕软件：PDF 的中国名片，力争全球领先》
- 2、协作办公领军企业：《致远互联：价值未被挖掘的企业 SaaS 入口》
- 3、产业信息化龙头深度：《朗新科技：做宽 B 端做大 C 端，稀缺的产业互联网平台企业》
- 4、物联网领先企业：《达实智能：2021E 18xPE 的物联网方案建设服务商，订单高景气》
- 5、信创行业深度：《总篇：信创，重塑中国 IT 产业基础的中坚力量》

7. 风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、市场竞争加剧。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15% 之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在 -5%—5% 之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15% 之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在 -10%—10% 之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、